

证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 公告编号：2023-060

湖北鼎龙控股股份有限公司

关于公司抛光液产品获得国内主流晶圆厂客户订单的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司武汉鼎泽新材料技术有限公司（以下简称“鼎泽新材料”）的多晶硅制程、氮化硅制程共 3 款抛光液产品于近期首次收到某国内主流晶圆厂商的采购订单。这是继公司此前介电材料抛光液、以自产氧化铝研磨粒子为基础的金属抛光液、钨抛光液、大硅片抛光液产品相继获得客户订单后，在完善全制程 CMP 抛光液市场服务方面取得的又一重要进展。

多晶硅（Poly-Si）与氮化硅（SiN）复合结构整合工艺是芯片器件制造流程中的关键，而平坦化制程更是重中之重，所使用的多晶硅抛光液（Poly slurry）技术难度相当高。截至目前，公司是某主流芯片制造大厂多晶硅制程抛光液产品通过验证的唯一国内供应商，其难点在于抛光液中的核心原材料研磨粒子难以自主化改良。公司抛光液团队自去年开始与该客户合作，针对芯片器件结构微观尺寸差异，自主合成定制化的研磨粒子，经过与客户紧密的技术配合，实现量产线验证通过。此次合作是公司在该主流客户首张单笔超过 500 万元的 CMP 抛光液订单，标志着鼎龙抛光液产品达到行业一流水平，获得客户认可。

目前，公司其他各制程 CMP 抛光液产品覆盖全国多家客户进入关键验证阶段，部分重点型号产品有望在今年下半年导入客户。产能方面，武汉本部工厂一期年产 5000 吨全自动化抛光液生产线能够满足客户端现期订单需求，仙桃年产 2 万吨 CMP 抛光液扩产项目及研磨粒子配套扩产项目预计于今年第四季度全面竣工，开始试生产供应，为后期持续稳定放量奠定基础。

上述订单的执行对公司的业务独立性不构成影响，公司主要业务不会因订单的执行而对客户形成依赖。后续公司将及时跟进上述订单的执行情况并履行相应的信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

湖北鼎龙控股股份有限公司董事会

2023年8月11日